PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-115028

(43)Date of publication of application: 24.04.2001

(51)Int.CI.

C08L 83/04 C08G 77/06 C08G 77/50 C08L 83/14 H01L 21/312 / C09D183/04 C09D183/14

(21)Application number: 2000-051136

(22)Date of filing:

28.02.2000

(71)Applicant: JSR CORP

(72)Inventor: HAYASHI EIJI

HASEGAWA KOICHI JO YOSHIHIDE

(30)Priority

Priority number: 11228498

Priority date: 12.08.1999

Priority country: JP

(54) COMPOSITION FOR FILM FORMING, METHOD FOR FORMING FILM AND SILICA-BASED FILM

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a composition for film forming excellent in dielectric constant properties and mechanical properties as an interlayer insulating film in a semiconductor element, etc., and capable of forming a silica-based film.

SOLUTION: The characteristic of this composition for film forming is to comprise (A) a hydrolytic condensate obtained by hydrolyzing and carrying out condensation at least one kind of a silane compound selected from the group of a compound represented by general formula (1): RaSi(OR1)4-a [R denotes H, F or a monovalent organic group; R1 denotes a monovalent organic group; and (a) denotes an integer of 1-2], a compound represented by general formula (2): Si(OR2)4 (R2 denotes a monovalent organic group) and a compound represented by general formula (3): R3b(R4O)3-bSi-(R7)d-Si(OR5)3-cR6c [R3 to R6 are same or different and denote each a monovalent organic group; b and c are same or different and denote each an integer of 0-2; R7 denotes O, phenylene group or a group represented by the following:-(CH2)n- (n is an integer of 1-6); and d denotes 0 or 1] in the presence of an alkaline compound in an amount of ≥0.1 mol based on 1 mol of the silane compound and (B) an organic solvent.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(II)特許出願公開番号 特開2001-115028 (P2001-115028A)

(43)公開日 平成13年4月24日(2001.4.24)

(51) Int.Cl.'	識別記号	FI		₹-	-マコード(参考)
COSL 83/04		C08L 83/04			
C08G 77/06	:	C 0 8 G 77/06			
77/50		77/50			
CO8L 83/14		CO8L 83/14			
HO1L 21/312	•	HO1L 21/312		C	
	審査請求	未請求 請求項の数7	OL	(全 13 頁)	最終頁に続く
(21)出願番号	特顧2000-51136(P2000-51136)	(71)出願人 000004	178		
(,		ジェイ	エスア・	ール株式会社	
(22)出願日	平成12年 2 月28日(2000. 2. 28)	東京都	中央区	築地2丁目11 都	路24号
		(72)発明者 林 英	治		
(31)優先権主張番号	特願平11-228498	東京都	中央区级	築地2丁目11都	1824号 ジェイ
(32)優先日	平成11年8月12日(1999.8.12)	エスア	ール株式	式会社内	
(33)優先権主張国	日本(JP)	(72)発明者 長谷川	公一		
		東京都	中央区约	英地2丁目11番	124号 ジェイ
		エスア	ール株式	式会社内	
		(72)発明者 徐 榮	秀		
		東京都	中央区勢	英地2丁目11種	124号 ジェイ
		エスア・	ール株式	式会社内	

(54) [発明の名称] 膜形成用組成物、膜の形成方法およびシリカ系膜

(57)【要約】

【課題】 半導体素子などにおける層間絶縁膜材料として、比誘電率特性および機械的強度に優れたシリカ系膜が形成可能な膜形成用組成物を得る。

【解決手段】 (A)下記一般式(1)で表される化合物、下記一般式(2)で表される化合物および下記一般式(3)で表される化合物の群から選ばれた少なくとも1種のシラン化合物を、シラン化合物1モルに対して

R', (R'O) :- Si-(R), -Si (OR) :- R', · · · ·

(3)

(式中、 R^1 ~R は同一または異なり、それぞれ1価の有機基、bおよびcは同一または異なり、 $0\sim2$ の数を示し、 R^1 は酸素原子、フェニレン基または— (CH

- 0.1モル以上のアルカリ性化合物の存在下で加水分解
- し、縮合した加水分解縮合物
- R₁ S i (OR') (1)

(式中、Rは水素原子、フッ素原子または1価の有機

- 基、R'は1価の有機基、aは1~2の整数を示す。)
- Si (OR'), (2)
- (式中、R'は1価の有機基を示す。)
- ,).一で表される基(ここで、nは $1\sim6$ の整数であ
- る)、dは0または1を示す。)ならびに (B) 有機溶 媒を含有することを特徴とする膜形成用組成物。

【特許請求の範囲】

(A) 下記一般式(1) で表される化 【請求項1】 合物、下記一般式(2)で表される化合物および下記一 般式 (3) で表される化合物の群から選ばれた少なくと も1種のシラン化合物を、シラン化合物1モルに対して 0.1モル以上のアルカリ性化合物の存在下で加水分解

(3)

〔式中、R'~R は同一または異なり、それぞれ1価 の有機基、bおよびcは同一または異なり、0~2の数 を示し、R' は酸素原子、フェニレン基または--(CH ,),一で表される基(ここで、nは1~6の整数であ る)、dは0または1を示す。) ならびに(B) 有機溶 媒を含有することを特徴とする膜形成用組成物。

【請求項2】 アルカリ性化合物がシラン化合物1モル に対して0.5モル以上であることを特徴とする請求項 1記載の膜形成用組成物。

【請求項3】 アルカリ性化合物がアンモニアおよび有 機アミンからなる群より選ばれることを特徴とする請求 項1記載の膜形成用組成物。

【請求項4】 有機アミンがアルキルアミン、アルカノ ールアミンおよびアリールアミンであることを特徴とす R^{i} , $(R^{i} O) \rightarrow Si - (R) \rightarrow Si (OR) \rightarrow R^{i}$

 \cdots (3)

 $[式中、R' \sim R]$ は同一または異なり、それぞれ 1 価 の有機基、bおよびcは同一または異なり、0~2の数 を示し、R' は酸素原子、フェニレン基または一(CH ,), -- で表される基 (ここで、nは1~6の整数であ る)、dは0または1を示す。〕

請求項1~4項記載の膜形成用組成物 【請求項6】 を基板に塗布し、加熱することを特徴とする膜の形成方 法。

【請求項7】 請求項6記載の膜の形成方法によって 得られるシリカ系膜。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、膜形成用組成物に 関し、さらに詳しくは、半導体素子などにおける層間絶 **縁膜材料として、比誘電率特性および機械的強度に優れ** たシリカ系膜が形成可能な膜形成用組成物に関する。 [0002]

【従来の技術】従来、半導体素子などにおける層間絶縁 膜として、CVD法などの真空プロセスで形成されたシ リカ (SiOi) 膜が多用されている。そして、近年、 より均一な層間絶縁膜を形成することを目的として、S OG (Spin on Glass) 膜と呼ばれるテト ラアルコキシランの加水分解生成物を主成分とする塗布 型の絶縁膜も使用されるようになっている。また、半導 体索子などの高集積化に伴い、有機SOGと呼ばれるポ リオルガノシロキサンを主成分とする低比誘電率の層間

し、縮合した加水分解縮合物

 $\cdots (1)$ R. Si (OR') ...

(式中、Rは水素原子、フッ素原子または1価の有機 基、R'は1価の有機基、aは1~2の整数を示す。) Si (OR') $\cdots (2)$

(式中、R'は1価の有機基を示す。)

R', $(R'O) \mapsto Si - (R)$, $-Si(OR) \mapsto R'$, \cdots

る請求項3記載の膜形成用組成物。

【請求項5】 有機溶媒中、下記一般式(1)で表され る化合物、下記一般式(2)で表される化合物、および 下記一般式(3)で表される化合物の群から選ばれた少 なくとも 1種のシラン化合物をシラン化合物 1モルに対 して0.1モル以上のアルカリ性化合物の存在下で加水 分解し、縮合することを特徴とする膜形成用組成物の製 造方法。

R. Si (OR') ... $\cdots \cdots (1)$

(式中、Rは水素原子、フッ素原子または1価の有機 基、R'は1価の有機基、aは1~2の整数を示す。) Si (OR') $\cdots (2)$

(式中、R'は1価の有機基を示す。)

絶縁膜が開発されている。しかしながら、半導体素子な どのさらなる高集積化や多層化に伴い、より優れた導体 間の電気絶縁性が要求されており、したがって、より低 比誘電率でかつクラック耐性に優れる層間絶縁膜材料が 求められるようになっている。

【0003】低比誘電率の材料としては、アンモニアの 存在下にアルコキシシランを縮合して得られる微粒子と アルコキシシランの塩基性部分加水分解物との混合物か らなる組成物 (特開平5-263045、同5-315 319) や、ポリアルコキシシランの塩基性加水分解物 をアンモニアの存在下縮合することにより得られた塗布 液(特開平11-340219、同11-34022 0) が提案されているが、これらの方法で得られる材料 はいずれも比誘電率が2.5を超えるものであり、半導 体素子などの高集積化、多層化には不十分であった。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記問題点 を解決するための膜形成用組成物に関し、さらに詳しく は、半導体素子などにおける層間絶縁膜として、低誘電 性に優れかつ機械的強度が改良されたシリカ系被膜を得 ることができる膜形成用組成物、その製造方法および該 組成物から得られるシリカ系膜を提供することを目的と する。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明は、(A)下記-般式(1)で表される化合物(以下「化合物(1)」と

もいう)、下記一般式(2)で表される化合物(以下 「(A)加水が 「(本中、Rは 「(本中、R)は 「(A)加水が 「(本中、R)は 「(本中、R)は 「(A)加水が 「(A)加水が 「(本中、R)は 「(本中、R)は 「(A)加水が 「(本中、R)は 「(A)加水が 「(本中、R)は 「(A)加水が 「(本中、R)は 「(A)加水が 「(本中、R)は 「(本中、R)

〔式中、R¹~R は同一または異なり、それぞれ1価の有機基、bおよびでは同一または異なり、0~2の数を示し、R¹は酸素原子、フェニレン基または一(CH1),一で表される基(ここで、nは1~6の整数である)、dは0または1を示す。〕ならびに(B)有機溶媒を含有することを特徴とする膜形成用組成物に関する。次に、本発明は、上記膜形成用組成物を基板に塗布し、加熱することを特徴とする膜の形成方法に関する。次に、本発明は、上記膜の形成方法によって得られるシリカ系膜に関する。

[0006]

【発明の実施の形態】本発明において、(A)加水分解 縮合物とは、上記化合物(1)~(3)の群から選ばれ た少なくとも1種の加水分解物およびその縮合物もしく はいずれか一方である。ここで、(A)成分における加 水分解物とは、上記 (A) 成分を構成する化合物 (1) ~ (3) に含まれるR O─基, R O─基, R O─ 基およびR'O一基のすべてが加水分解されている必要 はなく、例えば、1個だけが加水分解されているもの、 2個以上が加水分解されているものあるいはこれらの混 合物であってもよい。また、(A)成分における縮合物 は、(A) 成分を構成する化合物(1)~(3)の加水 分解物のシラノール基が縮合してSi-O-Si結合を 形成したものであるが、本発明では、シラノール基がす べて縮合している必要はなく、僅かな一部のシラノール 基が縮合したもの、縮合の程度が異なっているものの混 合物などをも包含した概念である。

【0007】 <u>(A) 加水分解縮合物</u>

(A) 加水分解縮合物は、上記化合物(1)~(3)の 群から選ばれた少なくとも1種のシラン化合物を特定量 のアルカリ性化合物の存在下に、加水分解、縮合して得 られる。

化合物(1);上記一般式(1)において、RおよびR の1価の有機基としては、アルキル基、アリール基、アリル基、グリシジル基などを挙げることができる。また、一般式(1)において、Rは1価の有機基、特にアルキル基またはフェニル基であることが好ましい。ここで、アルキル基としては、メチル基、エチル基、プロビル基、ブチル基などが挙げられ、好ましくは炭素数1~5であり、これらのアルキル基は鎖状でも、分岐していてもよく、さらに水素原子がフッ素原子などに置換されていてもよい。一般式(1)において、アリール基とし

「(A) 加水分解縮合物」ともいう)
R, Si(OR'), ... ・・・・・(1)
(式中、Rは水素原子、フッ素原子または1価の有機基、R'は1価の有機基、aは1~2の整数を示す。)
Si(OR'), ・・・・・(2)
(式中、R'は1価の有機基を示す。)

. (3)

ては、フェニル基、ナフチル基、メチルフェニル基、エチルフェニル基、クロロフェニル基、プロモフェニル基、フルオロフェニル基などを挙げることができる。 【0008】 化合物(1)の具体例としては、トリメトキシシラン、トリーiso一プロポキシシラン、トリーnープロポキシシラン、トリーiso一プロポキシシラン、トリーローブトキシシラン、トリーをertーブトキシシラン、フルオロトリエトキシシラン、フルオロトリーnープロポキシシラン、フルオロトリーローブロポキシシラン、フルオロトリーローブロポキシシラン、フルオロトリーローブトキシシラン、フルオロトリーならった。フルオロトリーならった。フルオロトリーはertーブトキシシラン、フルオロトリーはertーブトキシシラン、フルオロトリフェノキシシランなど;

【0009】メチルトリメトキシシラン、メチルトリエ トキシシラン、メチルトリーn-プロポキシシラン、メ チルトリーiso-プロポキシシラン、メチルトリーn **―**プトキシシラン、メチルトリ**―sec―プ**トキシシラ ン、メチルトリーtertーブトキシシラン、メチルト リフェノキシシラン、エチルトリメトキシシラン、エチ ルトリエトキシシラン、エチルトリーnープロポキシシ ラン、エチルトリーisoープロポキシシラン、エチル トリーnーブトキシシラン、エチルトリーsecーブト キシシラン、エチルトリーtertープトキシシラン、 エチルトリフェノキシシラン、ビニルトリメトキシシラ ン、ピニルトリエトキシシラン、ビニルトリーn-プロ ポキシシラン、ピニルトリーiso-プロポキシシラ ン、ピニルトリーnープトキシシラン、ピニルトリーs ec-ブトキシシラン、ビニルトリーtert-ブトキ シシラン、ピニルトリフェノキシシラン、nープロピル トリメトキシシラン、nープロピルトリエトキシシラ ン、n-プロピルトリ-n-プロポキシシラン、n-プ ロピルトリーiso-プロポキシシラン、n-プロピル・ トリーnープトキシシラン、nープロピルトリーsec **─**ブトキシシラン、n**─**プロピルトリ─tert─ブト キシシラン、nープロピルトリフェノキシシラン、iー プロピルトリメトキシシラン、i-プロピルトリエトキ シシラン、 i--プロピルトリーn-プロポキシシラン、 i-プロピルトリーiso-プロポキシシラン、i-プ ロビルトリーnーブトキシシラン、iープロビルトリー secープトキシシラン、iープロピルトリーtert ―ブトキシシラン、i―プロピルトリフェノキシシラ

ン、nープチルトリメトキシシラン、nープチルトリエ トキシシラン、n―ブチルトリ―n―プロポキシシラ ン、n-ブチルトリーis o-ブロポキシシラン、n-ブチルトリ—n-ブトキシシラン、n-ブチルトリーs ecープトキシシラン、nープチルトリーtertープ トキシシラン、n-ブチルトリフェノキシシラン、Se c-ブチルトリメトキシシラン、sec-ブチルトリエ トキシシラン、sec―ブチル―トリ―n―プロポキシ シラン、secーブチルートリーisoープロポキシシ ラン、secーブチルートリーnーブトキシシラン、s ecーブチルートリーsecーブトキシシラン、sec —ブチル—トリ—tert—ブトキシシラン、sec— ブチル―トリフェノキシシラン、t*―*ブチルトリメトキ シシラン、t--プチルトリエトキシシラン、t--プチル トリーnープロポキシシラン、tーブチルトリーiso *─*フロポキシシラン、t*─*プチルトリ─n─プトキシシ ラン、t-ブチルトリーsec-ブトキシシラン、t-プチルトリーtert―ブトキシシラン、t―ブチルト リフェノキシシラン、フェニルトリメトキシシラン、フ ェニルトリエトキシシラン、フェニルトリ**ー**n―プロポ キシシラン、フェニルトリーiso—プロポキシシラ ン、フェニルトリーnーブトキシシラン、フェニルトリ **─sec**─ブトキシシラン、フェニルトリ─tert─ **プトキシシラン、フェニルトリフェノキシシラン、ビニ** ルトリメトキシシラン、ピニルトリエトキシシラン、ア **―アミノプロピルトリメトキシシラン、γ**―アミノプロ **ピルトリエトキシシラン、γ**—グリシドキシプロピルト リメトキシシラン、γ--グリシドキシプロピルトリエト **キシシラン、γートリフロロプロビルトリメトキシシラ** ン、γ--トリフロロプロピルトリエトキシシランなど; 【0010】ジメチルジメトキシシラン、ジメチルジエ トキシシラン、ジメチル**ージー**nープロポキシシラン、 ジメチル―ジ―iso―プロポキシシラン、ジメチル― ジーnーブトキシシラン、ジメチルージーs e cープト キシシラン、ジメチルージーtert-ブトキシシラ ン、ジメチルジフェノキシシラン、ジエチルジメトキシ シラン、ジエチルジエトキシシラン、ジエチルージーn ─プロポキシシラン、ジエチルージーiso一プロポキ シシラン、ジエチルージーnープトキシシラン、ジエチ ルージーsecープトキシシラン、ジエチルージーte rtーブトキシシラン、ジエチルジフェノキシシラン、 ジーn-プロピルジメトキシシラン、ジーn-プロピル ジェトキシシラン、ジーnープロピルージーnープロポ キシシラン、ジーnープロピルージーisoープロポキ シシラン、ジ—n—プロピル—ジ—n—プトキシシラ ン、ジ—n—プロピル—ジ—sec—ブトキシシラン、 ジーnープロピルージーtert一プトキシシラン、ジ —n—プロビル—ジ—フェノキシシラン、ジ—iso— プロビルジメトキシシラン、ジーisoープロビルジエ トキシシラン、ジーisoープロビルージーnープロポ

キシシラン、ジーisoープロビルージーisoープロ ポキシシラン、ジーiso-プロピルージーn-ブトキ シシラン、ジーisoープロビルージーsecーブトキ シシラン、ジーiso-プロピルージーtert-ブト キシシラン、ジーiso-プロピルージーフェノキシシ ラン、ジ-n-ブチルジメトキシシラン、ジ-n-ブチ ルジェトキシシラン、ジーnーブチルージーnープロボ キシシラン、ジーnーブチルージーisoープロポキシ シラン、ジ--n--ブチル--ジ--n--ブトキシシラン、ジ ーnーブチルージーsecーブトキシシラン、ジーnー ブチルージーtertーブトキシシラン、ジーnープチ ルージーフェノキシシラン、ジーSecーブチルジメト キシシラン、ジーsecープチルジエトキシシラン、ジ ーsecーブチルージーnープロポキシシラン、ジーs ecープチルージーisoープロポキシシラン、ジーs ecーブチルージーnーブトキシシラン、ジーsecー ブチルージーsecーブトキシシラン、ジーsecーブ チルージーtertープトキシシラン、ジーsecーブ チルージーフェノキシシラン、ジーtertーブチルジ メトキシシラン、ジーtertープチルジエトキシシラ ン、ジーtert-ブチル-ジーn-プロポキシシラ ン、ジーtertープチルージーisoープロポキシシ ラン、ジーtertーブチルージーnープトキシシラ ン、ジーtertープチルージーsecーブトキシシラ ン、ジーtertープチルージーtertープトキシシ ラン、ジーtertープチルージーフェノキシシラン、 ジフェニルジメトキシシラン、ジフェニルージーエトキ シシラン、ジフェニルージ—n—プロポキシシラン、ジ フェニルージーiso―プロポキシシラン、ジフェニル ―ジーnープトキシシラン、ジフェニルージーSecー ブトキシシラン、ジフェニルージーtertーブトキシ シラン、ジフェニルジフェノキシシラン、ジビニルトリ メトキシシランなど;を挙げることができる。

【0011】化合物(1)として好ましい化合物は、メチルトリメトキシシラン、メチルトリエトキシシラン、メチルトリーiso一プロポキシシラン、エチルトリメトキシシラン、エチルトリエトキシシラン、エチルトリエトキシシラン、ピニルトリエトキシシラン、フェニルトリメトキシシラン、フェニルトリエトキシシラン、ジメチルジメトキシシラン、ジメチルジエトキシシラン、ジエチルジメトキシシラン、ジエチルジエトキシシラン、ジフェニルジメトキシシラン、ジフェニルジエトキシシランなどである。これらは、1種あるいは2種以上を同時に使用してもよい。

【0012】化合物(2);上記一般式(2)において、R'で表される1価の有機基としては、先の一般式(1)と同様な有機基を挙げることができる。化合物(2)の具体例としては、テトラメトキシシラン、テト

ラエトキシシラン、テトラ-n-プロポキシシラン、テ

トラーiso一プロポキシシラン、テトラーn一プトキシラン、テトラーsecープトキシシラン、テトラーtertープトキシシラン、テトラフェノキシシランなどが挙げられる。

【0013】 化合物(3); 上記一般式(3) におい て、R'~R で表される1価の有機基としては、先の 一般式(1)と同様な有機基を挙げることができる。 化 合物 (3) のうち一般式 (3) における R' が酸素原子 の化合物としては、ヘキサメトキシジシロキサン、ヘキ サエトキシジシロキサン、ヘキサフェノキシジシロキサ ン、1,1,1,3,3-ペンタメトキシー3-メチル ジシロキサン、1,1,1,3,3-ペンタエトキシー 3-メチルジシロキサン、1,1,1,3,3-ペンタ フェノキシ-3-メチルジシロキサン、1,1,1, 3, 3-ペンタメトキシ-3-エチルジシロキサン、 1, 1, 1, 3, 3-ペンタエトキシー3-エチルジシ ロキサン、1, 1, 1, 3, 3-ベンタフェノキシ-3 -エチルジシロキサン、1, 1, 1, 3, 3-ペンタメ トキシー3ーフェニルジシロキサン、1,1,1,3, 3-ベンタエトキシ-3-フェニルジシロキサン、1, 1, 1, 3, 3-ペンタフェノキシ-3-フェニルジシ ロキサン、1, 1, 3, 3-テトラメトキシ-1, 3-ジメチルジシロキサン、1,1,3,3-テトラエトキ シー1, 3-ジメチルジシロキサン、1, 1, 3, 3-テトラフェノキシー1,3一ジメチルジシロキサン、 1, 1, 3, 3ーテトラメトキシー1, 3ージエチルジ シロキサン、1, 1, 3, 3ーテトラエトキシー1, 3 ―ジェチルジシロキサン、1,1,3,3―テトラフェ ノキシー1, 3-ジエチルジシロキサン、1, 1, 3, 3-テトラメトキシ-1, 3-ジフェニルジシロキサ ン、1, 1, 3, 3ーテトラエトキシー1, 3ージフェ ニルジシロキサン、1,1,3,3-テトラフェノキシ -1, 3-ジフェニルジシロキサン、1, 1, 3-トリ メトキシー1, 3, 3-トリメチルジシロキサン、1, 1,3-トリエトキシー1,3,3-トリメチルジシロ キサン、1, 1, 3-トリフェノキシ-1, 3, 3-ト リメチルジシロキサン、1,1,3-トリメトキシー 1, 3, 3-トリエチルジシロキサン、、1, 1, 3-トリエトキシ---1,3,3--トリエチルジシロキサ ン、、1, 1, 3ートリフェノキシー1, 3, 3ートリ エチルジシロキサン、、1,1,3-トリメトキシー 1, 3, 3ートリフェニルジシロキサン、1, 1, 3ー トリエトキシ--1,3,3--トリフェニルジシロキサ ン、1, 1, 3-トリフェノキシ-1, 3, 3-トリフ ェニルジシロキサン、1,3-ジメトキシ-1,1, 3, 3-テトラメチルジシロキサン、1, 3-ジエトキ シー1, 1, 3, 3ーテトラメチルジシロキサン、1, 3—ジフェノキシー1, 1, 3, 3—テトラメチルジシ ロキサン、1, 3-ジメトキシ-1, 1, 3, 3-テト ラエチルジシロキサン、1,3-ジエトキシー1,1,

3, 3—テトラエチルジシロキサン、1, 3—ジフェノキシー1, 1, 3, 3—テトラエチルジシロキサン、1, 3—ジメトキシー1, 1, 3, 3—テトラフェニルジシロキサン、1, 3—ジエトキシー1, 1, 3, 3—テトラフェニルジシロキサン、1, 3—ジフェノキシー1, 1, 3, 3—テトラフェニルジシロキサンなどを挙げることができる。

【0014】これらのうち、ヘキサメトキシジシロキサン、ヘキサエトキシジシロキサン、1,1,3,3一テトラメトキシー1,3一ジメチルジシロキサン、1,1,3,3一テトラエトキシー1,3一ジメチルジシロキサン、1,1,3,3一テトラメトキシー1,3,3一テトラメチルジシロキサン、1,3一ジエトキシー1,1,3,3一テトラメチルジシロキサン、1,3一ジメトキシー1,1,3,3一テトラメチルジシロキサン、1,3一ジメトキシー1,1,3,3一テトラフェニルジシロキサン、1,3一ジエトキシー1,1,3,3一テトラフェニルジシロキサン、1,3一ジエトキシー1,1,3,3一テトラフェニルジシロキサン、1,3一ジエトキシー1,1,3,3一テトラフェニルジシロキサンなどを、好ましい例として挙げることができる。

【0015】また、一般式 (3) において、dが0の化 合物としては、ヘキサメトキシジシラン、ヘキサエトキ シジシラン、ヘキサフェノキシジシラン、1,1,1, 2, 2-ペンタメトキシ-2-メチルジシラン、1, 1, 1, 2, 2-ベンタエトキシ-2-メチルジシラ ン、1,1,1,2,2-ペンタフェノキシ-2-メチ ルジシラン、1, 1, 1, 2, 2-ペンタメトキシー2 --エチルジシラン、1, 1, 1, 2, 2-ペンタエトキ シー2-エチルジシラン、1,1,1,2,2-ペンタ フェノキシ-2-エチルジシラン、1,1,1,2,2 ─ベンタメトキシ─2─フェニルジシラン、1,1, 1, 2, 2-ペンタエトキシ-2-フェニルジシラン、 1, 1, 1, 2, 2-ペンタフェノキシ-2-フェニル ジシラン、1, 1, 2, 2-テトラメトキシー1, 2-ジメチルジシラン、1,1,2,2-テトラエトキシー 1, 2-ジメチルジシラン、1, 1, 2, 2-テトラフ ェノキシ-1, 2-ジメチルジシラン、1, 1, 2, 2 **−テトラメトキシ−1,2−ジエチルジシラン、1,** 1, 2, 2-rン、1, 1, 2, 2ーテトラフェノキシー1, 2ージェ チルジシラン、1,1,2,2-テトラメトキシー1, 2-ジフェニルジシラン、1,1,2,2-テトラエト キシ-1, 2-ジフェニルジシラン、1, 1, 2, 2-テトラフェノキシ-1,2-ジフェニルジシラン、1, 1, 2-トリメトキシ-1, 2, 2-トリメチルジシラ ン、1, 1, 2-トリエトキシ-1, 2, 2-トリメチ ルジシラン、1, 1, 2-トリフェノキシ-1, 2, 2 ートリメチルジシラン、1, 1, 2ートリメトキシー 1, 2, 2-トリエチルジシラン、、1, 1, 2-トリ エトキシー1, 2, 2ートリエチルジシラン、、1, 1、2--トリフェノキシ-1、2、2--トリエチルジシ

ラン、、1,1,2ートリメトキシー1,2,2ートリフェニルジシラン、1,1,2ートリエトキシー1,2,2ートリフェニルジシラン、、1,1,2ートリフェノキシー1,2,2ートリフェニルジシラン、1,2ージメトキシー1,1,2,2ーデトラメチルジシラン、1,2ージフェノキシー1,1,2,2ーデトラメチルジシラン、1,2ージフェノキシー1,1,2,2ーデトラメチルジシラン、1,2ージストキシー1,1,2,2ーデトラエチルジシラン、1,2ージフェノキシー1,1,2,2ーデトラエチルジシラン、1,2ージフェノキシー1,1,2,2ーデトラフェニルジシラン、1,2ージエトキシー1,1,2,2ーデトラフェニルジシラン、1,2ージエトキシー1,1,2,2ーデトラフェニルジシラン、1,2ージフェノキシー1,1,2,2ーデトラフェニルジシラン、1,2ージフェノキシー1,1,2,2ーデトラフェニルジシランなどを挙げることができる。

【0016】これらのうち、ヘキサメトキシジシラン、ヘキサエトキシジシラン、1,1,2,2一テトラメトキシー1,2一ジメチルジシラン、1,1,2,2一テトラエトキシー1,2一ジスチルジシラン、1,1,2、2一テトラメトキシー1,1,2,2一テトラメチルジシラン、1,2一ジエトキシー1,1,2,2一テトラメチルジシラン、1,2一ジエトキシー1,1,2,2一テトラフェニルジシラン、1,2一ジエトキシー1,1,2,2一テトラフェニルジシラン、1,2一ジエトキシー1,1,2,2一テトラフェニルジシランなどを、好ましい例として挙げることができる。

【0017】さらに、一般式 (3) において、R' が— (CH.) . 一で表される基の化合物としては、ビス (トリメトキシシリル) メタン、ピス (トリエトキシシ リル) メタン、ピス(トリーnープロポキシ**・**リル)メ タン、ビス (トリーiープロポキシシリル) メタン、ビ ス (トリーnーブトキシシリル) メタン、ビス (トリー sec-ブトキシシリル) メタン、ピス (トリーt-ブ トキシシリル) メタン、1,2―ピス(トリメトキシシ リル) エタン、1,2―ビス(トリエトキシシリル)エ タン、1,2--ピス (トリーn--プロポキシシリル) エ タン、1,2-ビス (トリーi-ブロポキシシリル) エ タン、1,2—ビス(トリ—n—ブトキシシリル)エタ ン、1, 2ービス (トリーsecーブトキシシリル) エ タン、1, 2—ビス (トリ—t—ブトキシシリル) エタ ン、1— (ジメトキシメチルシリル) —1— (トリメト キシシリル) メタン、1— (ジエトキシメチルシリル) -1- (トリエトキシシリル) メタン、1- (ジーn-プロポキシメチルシリル) ―1― (トリ―n―プロポキ シシリル) メタン、1**— (ジ—i —**プロポキシメチルシ リル) ―1― (トリ―i―プロポキシシリル) メタン、 1- (ジーnープトキシメチルシリル) -1- (トリー nープトキシシリル) メタン、1ー (ジーsecープト キシメチルシリル) ―1― (トリ―s e c―ブトキシシ

リル) メタン、1— (ジ—t —ブトキシメチルシリル) -1- (トリ-t-ブトキシシリル) メタン、1-(ジ メトキシメチルシリル) -2- (トリメトキシシリル) エタン、1-(ジエトキシメチルシリル)-2-(トリ エトキシシリル) エタン、1— (ジ—n—プロポキシメ チルシリル) ―2― (トリーn―プロポキシシリル) エ タン、1-- (ジーi-プロポキシメチルシリル) -2-(トリーiープロポキシシリル) エタン、1-(ジーn ーブトキシメチルシリル) -2- (トリーn-ブトキシ シリル) エタン、1-- (ジ-sec-ブトキシメチルシ リル) -2- (トリーsecーブトキシシリル) エタ ン、1— (ジーtーブトキシメチルシリル) **—2—** (ト リー・セーブトキシシリル) エタン、ピス (ジメトキシメ ・チルシリル)メタン、ピス(ジエトキシメチルシリル) メタン、ビス (ジ—n—プロポキシメチルシリル) メタ ン、ビス(ジーiープロポキシメチルシリル)メタン、 ビス (ジーnーブトキシメチルシリル) メタン、ビス (ジーsecーブトキシメチルシリル) メタン、ビス (ジーtーブトキシメチルシリル) メタン、1,2一ビ ス (ジメトキシメチルシリル) エタン、1, 2一ビス (ジェトキシメチルシリル) エタン、1,2一ビス (ジ -nープロポキシメチルシリル) エタン、1,2ービス (ジーiープロポキシメチルシリル) エタン、1,2-ビス (ジーnーブトキシメチルシリル) エタン、1,2 ─ビス (ジーs e c ーブトキシメチルシリル) エタン、 1, 2-ビス (ジーセーブトキシメチルシリル) エタ ン、1, 2-ビス (トリメトキシシリル) ベンゼン、 1, 2-ビス (トリエトキシシリル) ベンゼン、1, 2 ービス (トリーnープロポキシシリル) ベンゼン、1, 2-ビス (トリーiープロポキシシリル) ベンゼン、 1, 2-ビス (トリーn-ブトキシシリル) ベンゼン、 1, 2-ビス (トリーsec-ブトキシシリル) ベンゼ ン、1, 2-ビス (トリ-t- プトキシシリル) ペンゼ ン、1,3-ビス(トリメトキシシリル)ベンゼン、 1, 3-ビス (トリエトキシシリル) ベンゼン、1,3 ─ビス (トリ─n─プロポキシシリル) ペンゼン、1, 3-ビス (トリー・1-プロポキシシリル) ベンゼン、 1, 3-ビス (トリーロープトキシシリル) ベンゼン、 1, 3-ビス (トリーsec-ブトキシシリル) ベンゼ ン、1,3-ビス (トリーtープトキシシリル) ベンゼ ン、1,4-ビス(トリメトキシシリル)ベンゼン、 1, 4-ビス (トリエトキシシリル) ベンゼン、1,4 ─ビス (トリ─n─プロポキシシリル) ベンゼン、1, 4-ビス(トリー:-プロポキシシリル)ベンゼン、 1, 4-ビス (トリーn-ブトキシシリル) ベンゼン、 1, 4-ビス (トリーsec-ブトキシシリル) ベンゼ ン、1, 4-ビス (トリーt-ブトキシシリル) ベンゼ ンなど挙げることができる。

【0018】 これらのうち、ビス(トリメトキシシリ

ル) メタン、ピス (トリエトキシシリル) メタン、1,

2-ビス (トリメトキシシリル) エタン、1, 2-ビス (トリエトキシシリル) エタン、1一(ジメトキシメチ ルシリル) -1- (トリメトキシシリル) メタン、1-(ジェトキシメチルシリル) -1- (トリエトキシシリ ル) メタン、1-(ジメトキシメチルシリル) -2-(トリメトキシシリル) エタン、1一 (ジエトキシメチ ルシリル) ―2― (トリエトキシシリル) エタン、ビス (ジメトキシメチルシリル) メタン、ピス (ジエトキシ メチルシリル)メタン、1,2--ビス(ジメトキシメチ ルシリル) エタン、1,2-ビス (ジェトキシメチルシ リル) エタン、1,2一ピス (トリメトキシシリル) ベ ンゼン、1,2-ビス (トリエトキシシリル) ベンゼ ン、1, 3-ビス (トリメトキシシリル) ベンゼン、 1, 3-ビス (トリエトキシシリル) ベンゼン、1, 4 **―ピス (トリメトキシシリル) ベンゼン、1, 4―ピス** (トリエトキシシリル) ベンゼンなどを好ましい例とし て挙げることができる。

【0019】本発明において、(A)成分を構成する化合物(1)~(3)としては、上記化合物(1)、

(2) および (3) の1種もしくは2種以上を用いることができる。

【0020】なお、上記(A)成分を構成する化合物(1)~(3)の群から選ばれた少なくとも1種のシラン化合物を加水分解、縮合させる際に、R'O一基,R'O一基およびRO一基の総量1モル当たり、5~50モルの水を用いることが好ましく、7~30モルの水を加えることが特に好ましい。添加する水の量が5モルより少ない場合は、十分な比誘電率と弾性率が得られない場合があり、一方、50モルより多い場合は、加水分解および縮合反応中のポリマーの析出やゲル化が生じる場合がある。

【0021】本発明の(A)加水分解縮合物を製造する に際しては、上記化合物(1)~(3)の群から選ばれ た少なくとも1種のシラン化合物を加水分解、縮合させ る際に、特定量のアルカリ性化合物を用いることが特徴 である。本発明においてはアルカリ性化合物を特定量以 上用いることにより、低比誘電率でかつ高弾性率である シリカ系膜を得ることができる。本発明で使用すること のできるアルカリ性化合物としては、アンモニア(アン モニア水溶液を含む)、有機アミン、アルカリ性無機化 合物が挙げられるが、本発明においてはアンモニアおよ び有機アミンが好ましい。本発明において有機アミンと しては、アルキルアミン、アルカノールアミン、アリー ルアミンなどを挙げることができる。本発明で使用する ことのできるアルキルアミンとしては、メチルアミン、 エチルアミン、プロピルアミン、ブチルアミン、ヘキシ ルアミン、オクチルアミン、N, N-ジメチルアミン、 N, N-ジェチルアミン、N, N-ジプロピルアミン、 N, N-ジブチルアミン、トリメチルアミン、トリエチ ルアミン、トリプロピルアミン、トリプチルアミンなど

の炭素数1~4のアルキル基を有する化合物、メトキシ メチルアミン、メトキシエチルアミン、メトキシプロピ ルアミン、メトキシブチルアミン、エトキシメチルアミ ン、エトキシエチルアミン、エトキシプロピルアミン、 エトキシブチルアミン、プロポキシメチルアミン、プロ ポキシエチルアミン、プロポキシプロピルアミン、プロ ポキシブチルアミン、ブトキシメチルアミン、ブトキシ エチルアミン、ブトキシプロピルアミン、ブトキシブチ ルアミンなどのアルコキシ基を有する化合物などを挙げ ることができる。アルカノールアミンとしては、メタノ ールアミン、エタノールアミン、プロパノールアミン、 ブタノールアミン、N-メチルメタノールアミン、N-エチルメタノールアミン、N--プロピルメタノールアミ ン、N-ブチルメタノールアミン、N-メチルエタノー ルアミン、N-エチルエタノールアミン、N-プロビル エタノールアミン、N-ブチルエタノールアミン、N-メチルプロパノールアミン、N-エチルプロパノールア ミン、N-プロピルプロパノールアミン、N-プチルプ ロパノールアミン、N-メチルブタノールアミン、N-エチルブタノールアミン、N---プロピルブタノールアミ ン、N—ブチルブタノールアミン、N, N—ジメチルメ タノールアミン、N, N--ジエチルメタノールアミン、 N, N-ジプロピルメタノールアミン、N, N-ジブチ ルメタノールアミン、N, N-ジメチルエタノールアミ ン、N, N-ジエチルエタノールアミン、N, N-ジブ ロピルエタノールアミン、N, N-ジブチルエタノール アミン、N, N-ジメチルプロパノールアミン、N, N --ジェチルプロパノールアミン、N, N--ジプロピルブ ロパノールアミン、N, N-ジブチルプロパノールアミ ン、N, N-ジメチルブタノールアミン、N, N-ジエ チルプタノールアミン、N, N―ジプロピルブタノール アミン、N, N-ジブチルプタノールアミン、N-メチ ルジメタノールアミン、N-エチルジメタノールアミ ン、N-プロピルジメタノールアミン、N-プチルジメ タノールアミン、N-メチルジエタノールアミン、N-ェチルジェタノールアミン、N-プロピルジェタノール アミン、N-ブチルジエタノールアミン、N-メチルジ プロパノールアミン、N-エチルジプロパノールアミ ン、N-プロピルジプロパノールアミン、N-ブチルジ プロパノールアミン、N--メチルジブタノールアミン、 N—エチルジブタノールアミン、N—プロピルジブタノ ールアミン、N-ブチルジプタノールアミン、N-(ア ミノメチル) メタノールアミン、N-- (アミノメチル) エタノールアミン、N- (アミノメチル) プロパノール アミン、N- (アミノメチル) ブタノールアミン、N-(アミノエチル) メタノールアミン、N- (アミノエチ ル) エタノールアミン、N-- (アミノエチル) プロパノ ールアミン、N- (アミノエチル) ブタノールアミン、 N- (アミノプロピル) メタノールアミン、N- (アミ ノプロビル) エタノールアミン、N---(アミノプロビ

ル) プロパノールアミン、N- (アミノブロビル) ブタ ノールアミン、N-- (アミノブチル) メタノールアミ ン、N-- (アミノブチル) エタノールアミン、N-- (ア ミノブチル) プロパノールアミン、N-- (アミノブチ ル) ブタノールアミンなどを挙げることができる。また アリールアミンとしてはアニリンなどを挙げることがで きる。さらに有機アミンとしてテトラメチルアンモニウ ムハイドロキサイド、テトラエチルアンモニウムハイド ロキサイド、テトラプロピルアンモニウムハイドロキサ イド、テトラブチルアンモニウムハイドロキサイド、テ トラメチルエチレンジアミン、テトラエチルエチレンジ アミン、テトラプロピルエチレンジアミン、テトラブチ ルエチレンジアミン、メチルアミノメチルアミン、メチ ルアミノエチルアミン、メチルアミノプロピルアミン、 メチルアミノブチルアミン、エチルアミノメチルアミ ン、エチルアミノエチルアミン、エチルアミノプロピル アミン、エチルアミノブチルアミン、プロビルアミノメ チルアミン、プロピルアミノエチルアミン、プロビルア ミノプロピルアミン、プロピルアミノブチルアミン、ブ チルアミノメチルアミン、ブチルアミノエチルアミン、 ブチルアミノプロピルアミン、ブチルアミノブチルアミ ン、ピリジン、ピロール、ピペラジン、ピロリジン、ピ ベリジン、ピコリン、モルホリン、メチルモルホリン、 ジアザビシクロオクラン、ジアザビシクロノナン、ジア ザビシクロウンデセンなど挙げることができる。

【0022】これらのアルカリ性化合物は、1種あるいは2種以上を同時に使用してもよい。本発明においてアルカリ性化合物としては、アルキルアミンを用いるとシリカ系膜の基板への密着性の点からより好ましい。本発明において、アルカリ性化合物の使用量は前記化合物

(1) \sim (3) の合計 1 モルに対して 0. 1 モル以上、好ましくは 0. 5 モル以上、特に好ましくは 0. 9 モル以上である。本発明においてアルカリ性化合物の使用量の上限は特に制限ないが、シラン化合物 1 モルに対して、通常 1 0 モル未満である。

【0023】このようにして得られる(A)加水分解縮合物の慣性半径は、GPC(屈折率、粘度、光散乱測定)法による慣性半径で、好ましくは5~50nm、さらに好ましくは8~40nm、特に好ましくは9~20nmである。加水分解縮合物の慣性半径が5~50nmであると得られるシリカ系膜の比誘電率、弾性率および膜の均一性に特に優れるものとできる。また、このようにして得られる(A)加水分解縮合物は、粒子状の形態をとっていないことにより、基板状への塗布性が優れるという特徴を有している。粒子状の形態をとっていないことは、例えば透過型電子顕微鏡観察(TEM)により確認される。

[0024] なお、(A) 成分中、各成分を完全加水分 解縮合物に換算したときに、化合物(2)は、化合物 (1)~(3)の総量中、5~75重量%、好ましくは 10~70重量%、さらに好ましくは15~70重量%である。また、化合物(1)および/または(3)は、化合物(1)~(3)の総量中、95~25重量%、好ましくは90~30重量%、さらに好ましくは85~30重量%である。化合物(2)が、化合物(1)~(3)の総量中、5~75重量%であることが、得られる塗膜の弾性率が高く、かつ低誘電性に特に優れる。ここで、本発明において、完全加水分解縮合物とは、化合物(1)~(3)中のRO—基,RO—基およびRO—基が100%加水分解してSiOH基となり、さらに完全に縮合してシロキサン構造となったものをいう。また、(A)成分としては、得られる組成物の貯蔵安定性がより優れるので、化合物(1)および化合物(2)の加水分解縮合物であることが好まし

【0025】さらに、(A) 加水分解縮合物では、化合物(1)~(3) の群から選ばれた少なくとも1種のシラン化合物を、アルキルアミンの存在下に加水分解・縮合して、加水分解縮合物とし、好ましくはその慣性半径を5~50 nmとなすが、その後、組成物のpHを7以下に調整することが好ましい。pHを調整する方法としては、

①p H調整剤を添加する方法、

②常圧または減圧下で、組成物中よりアルカリ触媒を留 去する方法、

②窒素、アルゴンなどのガスをパブリングすることにより、組成物中からアルカリ触媒を除去する方法、

④イオン交換樹脂により、組成物中からアルカリ触媒を除く方法、

などが挙げられる。これらの方法は、それぞれ、組み合 わせて用いてもよい。

【0026】ここで、上記pH調整剤としては、無機酸 や有機酸が挙げられる。無機酸としては、例えば、塩 酸、硝酸、硫酸、フッ酸、リン酸、ホウ酸、シュウ酸な どを挙げることができる。また、有機酸としては、例え は、酢酸、プロピオン酸、ブタン酸、ペンタン酸、ヘキ サン酸、ヘプタン酸、オクタン酸、ノナン酸、デカン 酸、シュウ酸、マレイン酸、メチルマロン酸、アジピン 酸、セパシン酸、没食子酸、酪酸、メリット酸、アラキ ドン酸、シキミ酸、2一エチルヘキサン酸、オレイン 酸、ステアリン酸、リノール酸、リノレイン酸、サリチ ル酸、安息香酸、p-アミノ安息香酸、p-トルエンス ルホン酸、ベンゼンスルホン酸、モノクロロ酢酸、ジク ロロ酢酸、トリクロロ酢酸、トリフルオロ酢酸、ギ酸、 マロン酸、スルホン酸、フタル酸、フマル酸、クエン 酸、酒石酸、コハク酸、リンゴ酸、イタコン酸、シトラ コン酸、メサコン酸、クロトン酸、グルタル酸などを挙 げることができる。

【0027】上記pH調整剤による組成物のpHは、7以下、好ましくは $1\sim6$ に調整される。このように、加

水分解縮合物の慣性半径を5~50nmとなしたのち、 上記pH調整剤により上記範囲内にpHを調整すること により、得られる組成物の貯蔵安定性が向上するという 効果が得られる。pH調整剤の使用量は、組成物のpH が上記範囲内となる量であり、その使用量は、適宜選択 される。

【0028】(B)有機溶媒

本発明の膜形成用組成物は、(A)成分を、通常、

(B) 有機溶媒に溶解または分散してなる。この (B) 有機溶媒としては、アルコール系溶媒、ケトン系溶媒、 アミド系溶媒、エステル系溶媒および非プロトン系溶媒 の群から選ばれた少なくとも 1種が挙げられる。 ここ で、アルコール系溶媒としては、メタノール、エタノー ル、nープロパノール、iープロパノール、nーブタノ ール、iーブタノール、secーブタノール、tーブタ ノール、nーペンタノール、iーペンタノール、2ーメ チルブタノール、sec-ペンタノール、t-ペンタノ ール、3ーメトキシブタノール、nーヘキサノール、2 ーメチルベンタノール、sec-ヘキサノール、2-エ チルブタノール、secーヘプタノール、ヘプタノール -3、n-オクタノール、2-エチルヘキサノール、s ec-オクタノール、n-ノニルアルコール、2,6-ジメチルヘプタノール-4、n-デカノール、sec-ウンデシルアルコール、トリメチルノニルアルコール、 secーテトラデシルアルコール、secーヘプタデシ ルアルコール、フェノール、シクロヘキサノール、メチ ルシクロヘキサノール、3,3,5-トリメチルシクロ ヘキサノール、ベンジルアルコール、ジアセトンアルコ ールなどのモノアルコール系溶媒;

【0029】エチレングリコール、1,2-プロピレン グリコール、1,3-プチレングリコール、ペンタンジ オール-2,4、2-メチルペンタンジオール-2, 4、ヘキサンジオールー2,5、ヘプタンジオールー 2, 4、2-エチルヘキサンジオール-1,3、ジエチ レングリコール、ジプロピレングリコール、トリエチレ ングリコール、トリプロピレングリコールなどの多価ア ルコール系溶媒;エチレングリコールモノメチルエーテ ル、エチレングリコールモノエチルエーテル、エチレン グリコールモノプロピルエーテル、エチレングリコール モノブチルエーテル、エチレングリコールモノヘキシル エーテル、エチレングリコールモノフェニルエーテル、 エチレングリコールモノー2-エチルブチルエーテル、 ジェチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレン グリコールモノエチルエーテル、ジエチレングリコール モノプロピルエーテル、ジエチレングリコールモノブチ ルエーテル、ジエチレングリコールモノヘキシルエーテ ル、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピ レングリコールモノエチルエーテル、プロピレングリコ ールモノプロピルエーテル、プロピレングリコールモノ ブチルエーテル、ジプロピレングリコールモノメチルエ

ーテル、ジプロピレングリコールモノエチルエーテル、ジプロピレングリコールモノプロピルエーテルなどの多価アルコール部分エーテル系溶媒;などを挙げることができる。これらのアルコール系溶媒は、1種あるいは2種以上を同時に使用してもよい。

【0031】ケトン系溶媒としては、アセトン、メチル エチルケトン、メチル-n-プロビルケトン、メチルnープチルケトン、ジエチルケトン、メチルーiープチ ルケトン、メチルーnーペンチルケトン、エチルーnー プチルケトン、メチルーnーへキシルケトン、ジーiー ブチルケトン、トリメチルノナノン、シクロヘキサノ ン、2-ヘキサノン、メチルシクロヘキサノン、2,4 **-ペンタンジオン、アセトニルアセトン、アセトフェノ** ン、フェンチョンなどのほか、アセチルアセトン、2, 4-**ヘキサンジオン、2**, 4-**ヘプタンジオン、3**, 5 ―ヘプタンジオン、2,4―オクタンジオン、3,5― オクタンジオン、2, 4一ノナンジオン、3, 5一ノナ ンジオン、5--メチル--2,4--ヘキサンジオン、2, 2、6、6-テトラメチル-3、5-ヘプタンジオン、 1, 1, 1, 5, 5, 5-ヘキサフルオロー2, 4-ヘ プタンジオンなどのβ―ジケトン類などが挙げられる。 これらのケトン系溶媒は、1種あるいは2種以上を同時 に使用してもよい。

【0032】アミド系溶媒としては、ホルムアミド、Nーメチルホルムアミド、N, Nージメチルホルムアミド、N, Nージェチルホルムアミド、Nーエチルホルムアミド、Nーメチルアセトアミド、N, Nージメチルアセトアミド、Nーメチルアセトアミド、Nージェチルアセトアミド、Nーメチルアロピオンアミド、Nーメチルピロリドン、Nーホルミルビロリジン、Nーアセチルピロリジン、Nーアセチルピロリジン、Nーアセチルピロリジンなどが挙げられる。これらアミド系溶媒は、1種あるいは2種以上を同時に使用してもよい。

【0033】エステル系溶媒としては、ジェチルカーボネート、炭酸エチレン、炭酸プロピレン、炭酸ジェチル、酢酸メチル、酢酸エチル、アーブチロラクトン、アーバレロラクトン、酢酸nープロピル、酢酸iープロピ

ル、酢酸nーブチル、酢酸iーブチル、酢酸secーブ チル、酢酸n-ペンチル、酢酸sec-ペンチル、酢酸 3-メトキシブチル、酢酸メチルベンチル、酢酸2-エ チルプチル、酢酸2-エチルヘキシル、酢酸ベンジル、 酢酸シクロヘキシル、酢酸メチルシクロヘキシル、酢酸 n-ノニル、アセト酢酸メチル、アセト酢酸エチル、酢 酸エチレングリコールモノメチルエーテル、酢酸エチレ ングリコールモノエチルエーテル、酢酸ジエチレングリ コールモノメチルエーテル、酢酸ジエチレングリコール モノエチルエーテル、酢酸ジエチレングリコールモノー n-ブチルエーテル、酢酸プロピレングリコールモノメ チルエーテル、酢酸プロピレングリコールモノエチルエ ーテル、酢酸プロピレングリコールモノプロピルエーテ ル、酢酸プロピレングリコールモノブチルエーテル、酢 酸ジプロピレングリコールモノメチルエーテル、酢酸ジ プロピレングリコールモノエチルエーテル、ジ酢酸グリ コール、酢酸メトキシトリグリコール、プロピオン酸エ チル、プロピオン酸n-ブチル、プロピオン酸i-アミ ル、シュウ酸ジエチル、シュウ酸ジ---n--ブチル、乳酸 メチル、乳酸エチル、乳酸n-ブチル、乳酸n-アミ ル、マロン酸ジエチル、フタル酸ジメチル、フタル酸ジ エチルなどが挙げられる。これらエステル系溶媒は、1 種あるいは2種以上を同時に使用してもよい。非プロト ン系溶媒としては、アセトニトリル、ジメチルスルホキ シド、N, N, N´, N´ーテトラエチルスルファミ ド、ヘキサメチルリン酸トリアミド、N-メチルモルホ ロン、N-メチルピロール、N-エチルピロール、N-メチル—Δ3 —ピロリン、N—メチルピペリジン、N— エチルピペリジン、N, N-ジメチルピペラジン、N-メチルイミダゾール、N-メチル-4-ピペリドン、N -メチル-2-ピペリドン、N-メチル-2-ピロリド ン、1,3-ジメチル-2-イミダゾリジノン、1,3 **―ジメチルテトラヒドロ―2(1H)―ピリミジノンな** どを挙げることができる。以上の(B)有機溶媒は、1 種あるいは2種以上を混合して使用することができる。 【0034】本発明の膜形成用組成物は、(A)成分を 構成する化合物(1)~(3)を加水分解および/また は縮合する際に、同様の溶媒を使用することができる。 【0035】 具体的には、化合物(1)~(3)を溶解 させた溶媒中に水または溶媒で希釈した水を断続的ある いは連続的に添加する。この際、アルカリ性化合物は溶 媒中に予め添加しておいてもよいし、水添加時に水中に 溶解あるいは分散させておいてもよい。この際の反応温 度としては、通常、0~100℃、好ましくは15~9 0℃である。

【0036】その他の添加剤

本発明の膜形成用組成物には、界面活性剤、さらにコロイド状シリカ、コロイド状アルミナなどの成分を添加してもよい。

【0037】本発明に用いられる界面活性剤としては特

に制限はないが、例えば、シリコーン系界面活性剤、カチオン系界面活性剤、アニオン系界面活性剤、ノニオン系界面活性剤、両性界面活性剤、フッ累系界面活性剤、アクリル系界面活性剤などが挙げられ、これらは、1種単独であるいは2種以上を併用することができる。界面活性剤としては、シリコーン系、ノニオン系、フッ累系、アクリル系界面活性剤が好ましく、なかでも成膜性に優れ、金属腐食性ガスが発生しないことから、シリコーン系界面活性剤が特に好ましい。

【0038】ここで、シリコーン系界面活性剤としては、特に制限はないが、例えば、ジメチルポリシロキサンーポリオキシアルキレン共重合体を挙げることができる。シリコーン系界面活性剤の市販品としては、オルガノシロキサンポリマーKP341〔信越化学工業(株)製)、SH7PA、SH21PA、SH28PA、SH30PA、ST94PA(いずれも東レ・ダウコーニング・シリコーン製)などを挙げることができる。

【0039】また、カチオン系界面活性剤としては、アルキルアミン塩、第4級アンモニウム塩、ポリオキシアルキルアミンなどが挙げられる。さらに、アニオン系界面活性剤としては、脂肪酸塩、高級アルコール硫酸塩、アルキルベンゼンスルホン酸塩、ジフェニルエーテルジスルホン酸塩、ジアルキルジスルホサクシネート、アルキルホスフェート塩、ポリオキシエチレンサルフェート塩などが挙げられる。

【0040】さらに、ノニオン系界面活性剤としては、特に制限はないが、例えば、ポリオキシエチレンラウリルエーテル、ポリオキシエチレンステアリルエーテル、ポリオキシエチレンオレイルエーテルなどのポリオキシエチレンアルキルエーテル類;ポリオキシエチレンオクチルフェニルエーテル、ポリオキシエチレンアリールエーテル類;ポリオキシエチレンジラウレート、ポリオキシエチレンジステアレートなどのポリオキシエチレンジアルキルエステル類;ソルビタン脂肪酸エステル類;脂肪酸変性ポリオキシエチレン類;ポリオキシエチレン一ポリオキシブロビレンブロック共重合体などを挙げることができる

【0041】さらに、両性界面活性剤としては、特に制限はないが、先に挙げたアニオン系界面活性剤、カチオン系界面活性剤、ノニオン系界面活性剤の2つ以上が組み合わされた構造のものが挙げられる。

【0042】フッ素系界面活性剤としては、例えば1,1,2,2-テトラフロロオクチル(1,1,2,2-テトラフロロプロピル)エーテル、1,1,2,2-テトラフロロオクチルへキシルエーテル、オクタエチレングリコールジ(1,1,2,2-テル、ヘキサエチレングリコール(1,1,2,2,3,3-ヘキサフロロベンチル)エーテル、オクタプロピレングリコールジ(1,1,2,2-テトラフロ

ロブチル) エーテル、ヘキサプロピレングリコールジ (1, 1, 2, 2, 3, 3-ヘキサフロロベンチル) エ ーテル、パーフロロドデシルスルホン酸ナトリウム、 1, 1, 2, 2, 8, 8, 9, 9, 10, 10ーデカフ ロロドデカン、1, 1, 2, 2, 3, 3-ヘキサフロロ デカン、N-[3-(パーフルオロオクタンスルホンア ミド) プロビル] - N, N' -ジメチル-N-カルボキ シメチレンアンモニウムベタイン、パーフルオロアルキ ルスルホンアミドプロピルトリメチルアンモニウム塩、 パーフルオロアルキル-N-エチルスルホニルグリシン 塩、リン酸ビス(N-パーフルオロオクチルスルホニル -N-エチルアミノエチル)、モノパーフルオロアルキ ルエチルリン酸エステルなどの末端、主鎖および側鎖の 少なくとも何れかの部位にフルオロアルキルまたはフル オロアルキレン基を有する化合物からなるフッ素系界面 活性剤を挙げることができる。

【0043】フッ索系界面活性剤の市販品としては、メガファックF142D、同F172、同F173、同F183(以上、大日本インキ化学工業(株)製〕、エフトップEF301、同303、同352〔新秋田化成(株)製〕、フロラードFC-430、同FC-431〔住友スリーエム(株)製〕、アサヒガードAG710、サーフロンS-382、同SC-101、同SC-102、同SC-103、同SC-104、同SC-105、同SC-106〔旭硝子(株)製〕、BM-100、BM-1100(裕商(株)製〕、NBX-15〔(株)ネオス〕などの名称で市販されているフッ素系界面活性剤を挙げることができる。これらの中でも、上記メガファックF172、BM-1000、BM-11000、NBX-15が特に好ましい。

【0044】本発明で使用することのできるアクリル系 界面活性剤としては、(メタ)アクリル酸系共重合体な どを挙げることができ、ポリフローNo. 57,95 (共 栄社油脂化学工業(株)製)などの名称で市販されてい るものを挙げることができる。

【0045】コロイド状シリカとは、例えば、高純度の無水ケイ酸を上記親水性有機溶媒に分散した分散液であり、通常、平均粒径が5~30nm、好ましくは10~20nm、固形分濃度が10~40重量%程度のものである。このような、コロイド状シリカとしては、例えば、日産化学工業(株)製、メタノールシリカゾルおよびイソプロパノールシリカゾル; 触媒化成工業(株)製、オスカルなどが挙げられる。コロイド状アルミナとしては、日産化学工業(株)製のアルミナゾル520、同100、同200;川研ファインケミカル(株)製のアルミナクリアーゾル、アルミナゾル10、同132などが挙げられる。

【0046】<u>膜形成用組成物の調製方法</u> 本発明の膜形成用組成物を調製するに際しては、例え ば、溶媒中化合物(1)~(3)を混合して、水を連続 的または断続的に添加して、加水分解し、縮合し、

(A) 成分を調製したのち、これに (B) 成分を添加すればよく、特に限定されない。

【0047】本発明の組成物の調製方法の具体例としては、下記①-②の方法などを挙げることができる。

- Φ (A) 成分を構成する化合物(1) ~ (3)、アルカリ性化合物および(B) 有機溶媒からなる混合物に、所定量の水を加えて、加水分解・縮合反応を行う方法。
- ②(A) 成分を構成する化合物(1)~(3)、アルカリ性化合物および(B) 有機溶媒からなる混合物に、所定量の水を連続的あるいは断続的に添加して、加水分解、縮合反応う方法。
- ③ (A) 成分を構成する化合物(1)~(3) および
- (B) 有機溶媒からなる混合物に、所定量の水およびアルカリ性化合物を加えて、加水分解・縮合反応を行う方法。
- ④ (A) 成分を構成する化合物 (1) ~ (3) および (B) 成分からなる混合物に、所定量の水およびアルカリ性化合物を連続的あるいは断続的に添加して、加水分解、縮合反応を行なう方法。

【0048】このようにして得られる本発明の組成物の全固形分濃度は、好ましくは、2~30重量%であり、使用目的に応じて適宜調整される。組成物の全固形分濃度が2~30重量%であると、塗膜の膜厚が適当な範囲となり、保存安定性もより優れるものである。なお、この全固形分濃度の調整は、必要であれば、濃縮および上記(B)有機溶媒による希釈によって行われる。

【0049】本発明の組成物を用いて膜を形成するには、まず本発明の組成物を基板に塗布し、塗膜を形成する。ここで、本発明の組成物を塗布することができる基板としては、半導体、ガラス、セラミックス、金属などが挙げられる。また、塗布方法としては、スピンコート、ディッピング、ローラーブレードなどが挙げられる。本発明の組成物は、特にシリコンウエハ、SiNウエハ、SiNウエハなどの上に塗布され、絶縁膜とすることに適している。

【0050】この際の膜厚は、乾燥膜厚として、1回塗りで厚さ0.05~1.5 μ m程度、2回塗りでは厚さ0.1~3 μ m程度の塗膜を形成することができる。形成する塗膜の厚さは、通常、0.2~20 μ mである。この際の加熱方法としては、ホットブレート、オーブン、ファーネスなどを使用することができ、加熱雰囲気としては、大気下、窒素雰囲気、アルゴン雰囲気、真空下、酸素濃度をコントロールした減圧下などで行なうことができる。また、上記の(A)成分の硬化速度を制御するため、必要に応じて、段階的に加熱したり、窒素、空気、酸素、減圧などの雰囲気を選択することができる。このようにして得られる本発明のシリカ系膜は、膜密度が、通常、0.35~1.2g/cm、好ましくは0.4~1.1g/cm、さらに好ましくは0.5

~1. 0g/chである。膜密度が0.35g/cm '未満では、塗膜の機械的強度が低下し、一方、1.2g/cm'を超えると低比誘電率が得られない。また、本発明のシリカ系膜は、BJH法による細孔分布測定において、10nm以上の空孔が認められず、微細配線間の層間絶縁膜材料として好ましい。さらに、本発明のシリカ系膜は、吸水性が低い点に特徴を有し、例えば、塗膜を127℃、2.5atm、100%RHの環境に1時間放置した場合、放置後の塗膜のIRスペクトル観察からは塗膜への水の吸着は認められない。この吸水性は、本発明における膜形成用組成物に用いられる化合物(1)のテトラアルコキシシラン類の量により、調整することができる。さらに、本発明のシリカ系膜の比誘電率は、低比誘電率であり、通常、2.5~1.2、好ましくは2.4~1.2である。

【0051】本発明の低密度膜は、絶縁性に優れ、塗布膜の均一性、誘電特性、塗膜の耐クラック性、塗膜の表面硬度に優れることから、LSI、システムLSI、DRAM、SDRAM、RDRAM、D一RDRAMなどの半導体素子用層間絶縁膜、半導体素子の表面コート膜などの保護膜、多層配線基板の層間絶縁膜、液晶表示素子用の保護膜や絶縁防止膜などの用途に有用である。【0052】

【実施例】以下、本発明を実施例を挙げてさらに具体的に説明する。ただし、以下の記載は、本発明の態様例を概括的に示すものであり、特に理由なく、かかる記載により本発明は限定されるものではない。なお、実施例および比較例中の部および%は、特記しない限り、それぞれ重量部および重量%であることを示している。また、各種の評価は、次のようにして行なった。

【0053】慣性半径

下記条件によるゲルバーミエーションクロマトグラフィー (GPC) (屈折率、粘度、光散乱測定) 法により測定した。試料溶液:シラン化合物の加水分解縮合物を、固形分濃度が0.25%となるように、10mMのLiBrを含むメタノールで希釈し、GPC(屈折率、粘度、光散乱測定)用試料溶液とした。

装置: 東ソー (株) 製、GPCシステム モデル GP C-8020

東ソー (株) 製、カラム Alpha5000/300 0

ビスコテック社製、粘度検出器および光散乱検出器 モデル T-60 デュアルメーター

キャリア溶液: 10 mMのLiBrを含むメタノール キャリア送液速度: 1 ml/min

カラム温度:40℃

比誘電率

得られた膜に対して蒸着法によりアルミニウム電極バターンを形成させ比誘電率測定用サンブルを作成した。該サンブルを周波数100kHzの周波数で、横河・ヒュ

ーレットバッカード(株)製、HP16451B電極およびHP4284AプレシジョンLCRメータを用いて CV法により当該塗膜の比誘電率を測定した。

弾性率 (ヤング率)

得られた膜を、ナノインデンターXP (ナノインスツルメント社製)を用いて、連続剛性測定法により測定した。

【0054】実施例1

40%メチルアミン水溶液 6g、超純水 228gおよびエタノール570gの混合溶液中に、メチルトリメトキシシラン13.6g(完全加水分解縮合物換算6.7g)とテトラエトキシシラン20.9g(完全加水分解縮合物6g)を加えて、60℃で2時間反応させたのち、プロピレングリコールモノプロピルエーテル200.gを加え、その後、減圧下で全溶液量116gとなるまで濃縮し、その後、酢酸の10%プロピレングリコールモノプロピルエーテル溶液10gを添加し、固形分含有量10%の組成物溶液を得た。得られた組成物溶液中の加水分解縮合物の慣性は12nmであった。

実施例2

実施例1において40%メチルアミン水溶液6gのかわりに25%アンモニア水溶液98gを用いた以外は実施例1と同様にして固形分含有量10%の組成物溶液を得た。得られた組成物溶液中の加水分解縮合物の慣性は14nmであった。

実施例3

40%メチルアミン水溶液27g、超純水137gおよびエタノール342gの混合溶液中に、メチルトリメトキシシラン13.6g(完全加水分解縮合物換算6.7g)とテトラエトキシシラン28.7g(完全加水分解縮合物6g)を加えて、60℃で2時間反応させたのち、プロピレングリコールモノプロピルエーテル200gを加え、その後、減圧下で全溶液量116gとなるまで濃縮し、その後、酢酸の10%プロピレングリコールモノプロピルエーテル溶液10gを添加し、固形分含有量10%の組成物溶液を得た。得られた組成物溶液中の加水分解縮合物の慣性は26nmであった。

【0055】比較例1

(1) 実施例1 (1) において 40%メチルアミン水 溶液6gの代わりに25%アンモニア水溶液1gを用い た以外は、参考例1と同様の操作を行ない、固形分含有 量10%の組成物溶液を得た。得られた組成物溶液中の 加水分解縮合物の慣性は8nmであった。

膜の形成

上記実施例1~3および比較例1で得られた組成物を、8インチシリコンウエハ上にスピンコート法により塗布し、大気中80℃で5分間、次いで窒素下200℃で5分間加熱したのち、さらに真空下で340℃、360℃、380℃の順でそれぞれ30分間ずつ加熱し、さらに真空下425℃で1時間加熱し、無色透明のシリカ系

膜を形成した。得られたシリカ系膜について前述の評価

[0056]

を行った。結果を表1に示す。

【表1】

	実施例1	実施例2	実施例3	比較例1
比誘電率	2. 3	2. 2	2. 0	2. 6
弾性率 (G/Pa)	5. 5	5. 0	4. 0	2. 8

[0057]

械的強度の改良されたシリカ系膜が形成可能な膜形成用

【発明の効果】本発明によれば、低誘電性に優れかつ機

組成物を提供することができる。

フロントページの続き

(51) Int.Cl.

識別記号

FΙ

テーマコード(参考)

// C O 9 D 183/04

183/14

CO9D 183/04

183/14